

## ASML がイービームイニシャチブに参画

イービームイニシャチブが半導体フォトマスク並びに  
リソグラフィ分野からの参加企業数 50 社を達成

2019年2月26日（現地時間） 米国、カリフォルニア州、サンノゼ 発  
電子ビーム技術による新しい半導体製造技術への挑戦の啓蒙と促進に特化する公開の業界団体であるイービームイニシャチブは本日、ASMLホールディングズN.V.（ASML）がイービームイニシャチブに加わったと発表しました。半導体チップ製造装置業界で世界的なメーカーであるASMLは、半導体フォトマスク及びリソグラフィのサプライチェーンにおけるイービームイニシャチブの啓蒙活動に貴重な展望をもたらすことでしょう。

2009年、イービームイニシャチブは、半導体産業内におけるフォトマスクと半導体設計ならびに製造における電子ビーム技術を代表する意見を発した教育的環境を提供するプラットフォームとなる事を目的に立ち上げられました。

その努力の一端として、イービームイニシャチブは年次の技術展望調査とマスクメーカー動向調査により、新たな電子ビーム技術の導入を促進するために、関連業界に指針を提供しています。

会員企業50社と言う新たな足跡を印した今、イービームイニシャチブは今後とも引き続き、電子ビーム技術のエコシステム（個別企業・団体の有機的な集まり）を発展させるべく、その使命を追求し続けます。

本日、サンノゼの会議センターで開催されているSPIEのアドヴァンストリソグラフィ学会期間中に、イービームイニシャチブは年次昼食会を開催し、ASMLの上級副社長のユー・カオ氏、HJLリソグラフィ代表のハリー・レベンソン氏、そしてD2S社のチーフプロダクトオフィサー兼執行副社長であるレオ・パン氏が講演を行います。これら業界の権威は、フォトマスクとリソグラフィの将来における成功の鍵となる電子ビームに関連する幾つかの話題、即ちEUVリソグラフィに関する計算機処理、フォトマスクの為の深層学習への応用を可能とするGPU加速シミュレーション、そして計算機リソグラフィにおける機械学習の応用を取り上げる予定です。これらの発表資料は現地時間2月26日夕刻以降、イービームイニシャチブのウェブサイト（[www.ebeam.org](http://www.ebeam.org)）から入手出来ます。

「ASMLはイービームイニシャチブのメンバーに貴重な展望を提供する事になるでしょう。ASMLはリソグラフィ工程のモデル化やシミュレーション技術に対してのみならず、HMI社の買収により電子ビームによる計測や検査技術においても際立った専門的能力を有しておられます。この事により、計算機リソグラフィ技術並びに計測技術や検査技術に関連する電子ビームによるマスク描画に対して、今までになかった識見をもたらすでしょう。電子ビーム技術における革新を継続するために、これまで以上にイービームイニシャチブにおける様な業界挙げての協調努力が重要となります。電子ビーム技術により、新しい半導体製造技術を目指す

我々の使命実現に貢献して頂ける最も新しい会員として ASML 社を歓迎いたします。」と、イービームイニシャチブの運営幹事会社 D2S 社の最高経営責任者である藤村晶氏は述べています。

#### イービームイニシャチブとは

イービームイニシャチブは電子ビーム技術に基づく新しい半導体製造方法の探求の為の啓蒙・啓発活動を目的として、公開討論の場を提供しています。

その目指すものは、半導体のエコシステム全体を通じて電子ビーム技術への投資が増え続けるなか、より多くの集積回路 (IC) の設計に着手することを可能とし、またより迅速な商品化を可能とする手段の選択をする時の障害を低減することです。

会員は半導体エコシステム各方面から構成され、次にあげる各社、各機関よりなります。

aBeam Technologies; アドバンテスト (Advantest); Alchip Technologies; AMTC; Applied Materials; Artwork Conversion; Aselta Nanographics; ASML; Cadence Design Systems; キヤノン (Canon); CEA-Leti; D2S; 大日本印刷 (Dai Nippon Printing); EQUIcon Software GmbH Jena; eSilicon Corporation; Fraunhofer CNT; 富士通セミコンダクター (Fujitsu Semiconductor Limited); GenISys GmbH; GLOBALFOUNDRIES; Grenon Consulting; 日立ハイテクノロジーズ (Hitachi High-Technologies); ホロン株式会社 (HOLON CO., LTD.); HOYA 株式会社 (HOYA Corporation); IMS CHIPS; IMS Nanofabrication AG; 日本電子 (JEOL); KLA-Tencor; Maglen; Mentor, a Siemens Business; Multibeam Corporation; 日本コントロールシステム (NCS); ニューフレアテクノロジー (NuFlare Technology); Petersen Advanced Lithography; Photonics; Sage Design Automation; Samsung Electronics; Semiconductor Manufacturing International (Shanghai) Corporation (SMIC); STMicroelectronics; Synopsys; tau-Matrix; Tela Innovations; 東京エレクトロン (TEL); TOOL 株式会社 (TOOL Corporation); 凸版印刷 (Toppan Printing); 東芝 (Toshiba); UBC Microelectronics; Vistec Electron Beam GmbH; Xilinx 及び ZEISS.

電子業界に属する会社、機関であればどなたでもイービームイニシャチブの会員にお成りいただけます。詳しくは [www.ebeam.org](http://www.ebeam.org) をご覧下さい。

本件に関するお問い合わせ先：

報道関係の方のお問い合わせは：

David Moreno

Open Sky Communications

Tel: +1-415-519-3915

E-mail: [dmoreno@openskypr.com](mailto:dmoreno@openskypr.com)

まで、英語にて、

報道関係以外の方のお問い合わせは：

株式会社 D2S (事務局)

田中 喜男

電話：045-479-8390 (代)

電子メール：[ytanaka@design2silicon.com](mailto:ytanaka@design2silicon.com)

までお願いします。

以上